## RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY

02-27-2007



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Patent and Trademark Office

8.0 2/1

8.0 131097

	1033/5/1	O		Attorney Docker 110.	131027	<u> </u>
	Please record the attached ori	iginal	docu	ment or copy thereof.		<del>-</del>
1.	A. Name of conveying parties:	2.	A.	Name and address of receiving	parties:	-
	<ul><li>[1] Yukimune WATANABE</li><li>[2] Nobuyuki MISE</li><li>[3] Shinji MIGITA</li></ul>			SEIKO EPSON CORPOR 4-1, NISHI-SHINJUKU 2 SHINJUKU-KU, TOKYO	-CHOME,	
<u></u>	B. Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  ☐ Yes ☒ No			RENESAS TECHNOLOC 4-1, MARUNOUCHI 2-C CHIYODA-KU, TOKYO,	НОМЕ,	ATION
3.	A. Nature of conveyance:		В.	Additional name(s) & address(c	es) attached?	
	☐ Security Agreement ☐ Change of Name					
	Other					
	<ul><li>B. Execution Date: [1] February 16, 2007</li><li>[2] February 9, 2007</li><li>[3] February 8, 2007</li></ul>					
4.	This document is being filed together with a new application	ation.				
	A. Patent Application No.(s)		В.	Patent No.(s)		
	Additional numbers att	i tache	d? [	☐ Yes 🏿 No		
<u>SE</u>	C. Title of Application: <u>METHOD FOR FORMING S</u> MICONDUCTOR DEVICE	<u>SILIO</u>	<u>CIDE</u>	AND METHOD FOR FAB	RICATING	
5.	Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:	6.	Tota	al number of applications and pate	ents involved:	1
	Name: James A. Oliff	7.	Α.	Total fee (37 CFR 3.41)	\$ 40.00	
			В.	Enclosed (Check No. 189746	)	
	Address: OLIFF & BERRIDGE, PLC P.O. Box 19928 Alexandria, VA 22320	8.		dit any overpayment or charge anyosit account number 15-0461.		
				OLICOTONI LINCELLER NUMBER	/	\
				01 FC:8021	4(	0.00 OP
9.	Statement and signature.  To the best of my knowledge and belief, the foregoing informational document.  James A. Oliff, Registration No. 27,075	ation	is tru	e and correct and any attached co		- N
	Linda M. Saltiel, Registration No. 51,122	cludi	na co	ver sheet, attachments, and docun	nent: 7	
	Total Hamber of pages in	,oradi	11g 00	ver sneet, attachments, and docum	11C111. /	

## Seike Epson Ref. No.: J0125665US01

# 譲渡証(Translation/日本語訳)

下記に据るした私/私達、

#### 波邊 奉宗、三瀬 信行、石田 真司

ある死明を創出し、これについて合衆国特許出頭は

$\boxtimes$	◯ ここに私/私遊により署名され,					
	に私ノ	を表により	(それぞれ)	寒名 され		
	に出版され、	出願番号	が交付さ	<b>.</b>		
	PCT 国際出願	!とし	てに出	腐され、		

### その発明は

## シリサイドの形成方法及び半導体装置の製造方法

という名称である。 そして、ここにその受領を認める対価で: 私/私途は、当該発明/出版について、合衆国とその属領及び 全ての外国に於ける全面的かつ独占的な権利;合衆国とその属 領及び全ての外国に於いて発行される特許証に関わる全ての 権利、所有権、利益; 一部權能出頭、越校出額、分割出頭、 差替え出頭、再発行出頭、特許期間延長等、合衆国とその周領 及び全ての外国に於いて既に出頭されたか若しくは今復盟 される特許に関わる全での権利;そして、国際条約、同盟、契 約、法令、協定(特殊側定されるものを合む)に基づを明 の後を伴う一切の権利;を、日本国東京都新宿区の新宿で 日4番1号に住所を有するセイコーエブソン株式会社、及び日 本国東京都千代田区丸の内2丁目4番1号に住所を有する株 式会社ルネサステクノロジ、その後継者、該受人及び性定代理 人に対して、売却、誤飯、移転するものとする。

さらに、私/私達は、セイコーエプソン株式会社及び株式会社 ルネサステクノロジ、(以下設受人と言う)が単数ないしは複 数の当該発明(以下当該発明という)に関わる特許権を、自己 の名により、合衆国とその属領及び全ての外国に於いて出願 し、特許を受けること;またこの譲渡証の意図と目的を誠実に 実行することを求められた場合、下記に署名した私/私達が、 当該確契人、その後継者、その被譲奪者、及び法定代理人の費 用負担にて、一部総統出版、総統出版、分割出版、臺灣之出版、 再発行出版、特許期間延長等を行い、合法的宣誓書、政復託、 委任状等の書類を作成し、あらゆる法的主たは頑法的訴訟手続 に於いて証言を行うこと:当該発明とその経緯に関連して、下 記に著名した私/私達が知り得た全ての事実を、当該孫受人、 後離者、被擬液者、及び法定代理人に逐絡すること;そして当 故談受人、後継者、被談被者、及び注定代理人が、当該発明の 特許権の適切な保護、維持、権利行便するために望ましいと考 慮すること、また、当該発明に関わる特許出願に際し、当該譲 受人、後継者、彼孫極者、及び法定代理人に対して法的権限を 付与することが望ましいと考慮することについて、可能な限り 行うことを承諾する。

# Assignment

For good and valuable consideration, the receipt of which is hereby asknowledged, I/WE, the undersigned.

#### Yukimune WATANABE, Nobuyuki MISE, Shinii MIGITA

who have created a certain invention for which an application for United States Letters Patent

$\boxtimes$	executed by ME/US on even date herewith, axecuted by ME/US on, (respectively).
	filed on and assigned Serial No filed on
nd entiti	e 9 <del>ti</del> :

METHOD FOR FORMING SELICIDE AND METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE

Do heraby sail, pasign and transfer to Seike Epson Corporation. a corporation of Japan, having a place of business at 4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, and Renesss Technology Corporation, having a piace of business at 4-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan their respective suppossors, assigns, and legal representatives, the full and exclusive right to said invention and said application and to any and all inventions described in said application for the United States, its territorial possessions and all foreign countries, and the entire right title and interest in and to any and all Letters Patent which may be granted therefor in the United States, its territorial possessions and all foreign countries; and in and to any and all continuations impart continuations, divisions, substitutes. reissues, extensions thereof, and all other applications for Letters Patent relating thereto which have been or shall be filed in the United States, its territorial possessions and/or any foreign countries, and all rights, together with all priority rights, under any of the international conventions, unions, agreements, acts, and treaties, including all future conventions, unions, agreements, acts, and treaties;

Agree that Seiko Epson Corporation and Renesas Technology Corporation hareinafter referred to as Assignees, may apply for and receive Letters Patent for said invention and said inventions, hereinafter referred to as said invention, in their own name, in the United States, its territorial possessions, and all foreign countries; and that when requested to carry out in good faith the intent and purpose of this assignment, at the expense of said Assigness, their successors, assigns and legal representatives, the undersigned will axecute all continuations impart, continuations, divisions, substitutes, reissues, extensions thereof, execute all rightful caths, assignments, powers of attorney and other papers, testify in any legal or quest legal proceedings; communicate to said Assigness. their successors, essigns or legal representatives all facts known to the undersigned relating to said invention and the history thereof: and generally do everything possible which said Assignees, their respective auccessors, assigns, or legal representatives shall consider desirable for aiding in securing, maintaining and enforcing proper patent protection for said invention and for vesting title to said invention and all applications for patents on said invention in said Assignees, their successors, assigns, or legal representatives: and

Page 1 of 2

### Seiko Epson Rof. No.: J0125665US01

そして、私/私達は、この書面により移転された権利や財産に Covenant with said Assignees, their respective successors. 影響する、如何なる譲渡、授権、抵当権、ライセンス等その他 の協定も他の第三省との間で行っていないこと: 下記に署名 した私/私達によって、この書面に記載されている権利が所有 されていることを、当該疏受人、後継者、被頑疲者、及び往定 代理人に対して誓約するものである。

さらに、下記に署名した私/私達はこの疏波否は英語の部分の 変現によってのみ解釈されることに同意する。

上記を証明するため、私/私達は下記日付で署名する。

accigns, or legal representatives that no assignment grant mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made to others by the undersigned, and that full right to convey the same as herein expressed is possessed by the undersigned.

I/WE, the undereigned do further agree that this Assignment is to be construed solely according to the terms of the English language portions thereof.

IN TESTIMONY WHEREOF I/WE have hereunts set MY/OUR signature seel on the date indicated below.

唯一または第一発明者名		Full name of sole or first inventor	
渡邊 幸宗		Yukimune WATANABE	
売明者の署名	日付 2007年2月16日	Inventor's signature	Date FEB /6, 2007
渡追幸	宗.	Yukimune Watenabe	
第二共同発明者(いる場合) 三瀬 信行		Full name of second joint inventor, if any Nobuyuki MISE	
第二共同発明者の署名	目付 ,	Second Inventor's signature	Date
第三共同発明者(L'る場合) 智田 真司		Full name of third joint inventor, if any Shinji MIGITA	
<b>第三共同発明者の著名</b>	<b>B</b> 10	Third Inventor's signature	Date
節四共同発明者 (いる場合)	-	Full name of fourth joint inventor, if any	
第四共同発明者の著名	日付	Fourth Inventor's signature	Date
第五共同発明者 (L\る場合)		Full name of fifth joint inventor, if any	
医五共同発明者の署名	日付	Fifth Inventor's signature	Date
第六共同発明者(いる場合)		Full name of sixth joint inventor, if any	
<b>第六共局免明者の署名</b>	<b>∃ (</b> ♥	Sixth Inventor's signature	Data
第七共同免明者(いる場合)		Full name of seventh joint inventor, if any	,
第七共同発明者の著名	8付	Seventh imeyr's signature	Date
第八共屈発明者 (いる場合)		Full name of eighth joint inventor, if any	
第八共同多明者の著名	日付	Eighth Inventor's signature	Date
<del></del>			<del></del>

Page 2 of 2

Seiko Epsor	Ref. No.:	J0125665US01

# . 譲渡証(Translation/日本語訳)

下記に署名した私/私達、

#### 渡邉 幸泉、三瀬 信行、右田 真司

ある発明を創出し、これについて合衆国特許出願は

$\boxtimes$	ここに私/私	(達により署)	名され,	
	に私/	′私達により	(それぞれ)	署名され
	に出願され,			
	PCT 国際出願	:とし	てに出	願され,

#### その発明は

### シリサイドの形成方法及び半導体装置の製造方法

という名称である。 そして、ここにその受領を認める対価で: 私/私達は、当該発明/出願について、合衆国とその展領及び 全ての外国に於ける全面的かつ独占的な権利;合衆国とその属 領及び全ての外国に於いて発行される特許証に関わる全ての 権利、所有権、利益:一部継続出願、継続出願、分割出願、 差替え出額、再発行出源、特許期間延長等、合衆国とその属領 及び全ての外国に於いて既に出願されたか若しくは今後出顧 される特許に関わる全ての権利;そして、国際条約、同盟、契 約、法令、協定(将来制定されるものを含む)に基づく全ての 優先権を伴う一切の権利;を、日本国東京都新宿区西新宿2丁 目4番1号に住所を有するセイコーエブソン株式会社、及び日 本国東京都千代田区丸の内2丁目4番1号に住所を有する株 式会社ルネサステクノロジ、その後継者、議受人及び法定代理 人に対して、売却、譲渡、移転するものとする。

さらに、私/私達は、セイローエプソン株式会社及び株式会社 ルネサステクノロジ、(以下譲受人と言う)が単数ないしは複 数の当該発明(以下当該発明という)に関わる特許権を、自己 の名により、合衆国とその属領及び全ての外国に於いて出願 し、特許を受けること;またこの譲渡証の意図と目的を誠実に 実行することを求められた場合、下記に署名した私/私達が、 当旅譲受人、その後継者、その被譲渡者、及び法定代理人の費 用負担にて、一部継続出願、継続出願、分割出願、差替え出願、 再発行出願、特許期間延長等を行い、合法的宣誓書、護渡証、 委任状等の書類を作成し、あらゆる法的または準法的訴訟手続 に於いて証言を行うこと:当該発明とその経緯に関連して、下 記に署名した私/私達が知り得た全ての事実を、当該議受人、 後継者、被譲渡者、及び法定代理人に連絡すること;そして当 該設受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人が、当該発明の 特許権の適切な保護、維持、権利行使するために望ましいと考 慮すること、また、当該発明に関わる特許出顧に際し、当該譲 受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人に対して法的権限を 付与することが望ましいと考慮することについて、可能な限り 行うことを承諾する。

# Assignment

For good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, I/WE, the undersigned,

### Yukimune WATANABE, Nobuyuki MISE. Shinji MIGITA

who have created a certain invention for which an application for United States Letters Patent

×	executed by ME/US on even date herewith.	
Ħ	filed on and assigned Serial No	
	filed as International Application No filed o	n

FOR FORMING SILICIDE AND METHOD FOR METHOD FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE

Do hereby sell, assign and transfer to Selko Epson Corporation. a corporation of Japan, having a place of business at 4-1. Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, and Renesas Technology Corporation, having a place of business at 4-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda ku, Tokyo, Japan their respective successors, assigns, and legal representatives, the full and exclusive right to said invention and said application and to any and all inventions described in said application for the United States, its territorial possessions and all foreign countries, and the entire right, title and interest in and to any and all Letters Patent which may be granted therefor in the United States, its territorial possessions and all foreign countries; and in and to any and all continuations-in-part, continuations, divisions, substitutes, reissues, extensions thereof, and all other applications for Letters Patent relating thereto which have been or shall be filed in the United States, its territorial possessions and/or any foreign countries, and all rights, together with all priority rights, under any of the international conventions, unions, agreements, acts, and treaties, including all future conventions, unions, agreements, acts, and treaties;

Agree that Seiko Epson Corporation and Renesas Technology Corporation hereinafter referred to as Assignees, may apply for and receive Letters Patent for said invention and said inventions. hereinafter referred to as said invention, in their own name, in the United States, its territorial possessions, and all foreign countries; and that, when requested to carry out in good faith the intent and purpose of this assignment, at the expense of said Assignees, their successors, assigns and legal representatives, the undersigned will execute all continuations-in-part continuations, divisions, substitutes, reissues, extensions thereof, execute all rightful oaths, assignments, powers of attorney and other papers, testify in any legal or quasi legal proceedings; communicate to said Assignees. their successors, assigns or legal representatives all facts known to the undersigned relating to said invention and the history thereof; and generally do everything possible which said Assignees, their respective successors, assigns, or legal representatives shall consider desirable for aiding in securing, maintaining and enforcing proper patent protection for said invention and for vesting title to said invention and all applications for patents on said invention in said Assignees, their successors, assigns, or legal representatives;

Page 1 of 2

### Seiko Epson Ref. No.: J0125665US01

そして、私/私達は、この書面により譲渡された権利や財産に の協定も他の第三者との間で行っていないこと: 下記に署名 した私/私達によって、この各面に記載されている権利が所有 されていることを、当該護受人、後継者、被譲渡者、及び法定 代理人に対して誓約するものである。

さらに、下記に署名した私/私達はこの譲渡者は英語の部分の 表現によってのみ解釈されることに同意する。

上記を証明するため、私/私達は下記日付で署名する。

Covenant with said Assignees, their respective successors, 影響する、如何なる譲渡、授権、抵当権、ライセンス等その他 assigns, or legal representatives that no assignment, grant, mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made to others by the undersigned, and that full right to convey the same as herein expressed is possessed by the undersigned.

> I/WE, the undersigned do further agree that this Assignment is to be construed solely according to the terms of the English language portions thereof.

> IN TESTIMONY WHEREOF I/WE have hereunto set MY/OUR signature seal on the date indicated below.

唯一または第一発明者名 渡邉 幸宗		Full name of sole or first inventor Yukimune WATANABE	
発明者の著名	BH	Inventor's signature	Date
第二共同発明者 (いる場合) 三瀬 信行		Full name of second joint inventor, if an Nobuyuki MISE	ny
第二共同発明者の署名	日付	Second Inventor's signature	Date Telorwary 9, 2007
第三共同発明者 (いる場合) 右田 真司		Oobiyati Mise F Full name of third joint inventor, if any Shinji MIGITA	20,000
第三共同発明者の著名	日付	Third Inventor's signature	Date
第四共同発明者(いる場合)		Full name of fourth joint inventor, if any	
<b>第四共同発明者の署名</b>	日 <b>时</b>	Fourth Inventor's signature	Date
第五共同発明者 (いる場合)		Full name of fifth joint inventor, if any	
<b>宗玉共同発明者の署名</b>	日付	Fifth <b>I</b> nventor's signature	Date
第六共同発明者(いる場合)		Full name of sixth joint inventor, if any	
第六共同発明者の著名	日付	Sixth Inventor's signature	Date
第七共同発明者(いる場合)		Full name of seventh joint inventor, if a	ту
第七共同発明者の署名	日付	Seventh Inventor's signature	Date
第八共同発明者 (いる場合)		Full name of eighth joint inventor, if any	
第八共同発明者の署名	日付	Eighth Inventor's signature	Date

Page 2 of 2

Şeiko Er	son Ref.	No.:	J01	<u> 25665</u>	<b>US01</b>

## ·譲渡証(Translation/日本語訳)

下記に署名した私/私達、

#### 渡邉 孝宗、三瀬 信行、右田 真司

ある発明を創出し、これについて合衆国特許出頭は

$\boxtimes$	ここに私/私	(達により署	名され,	
	に私/			
	に出願され、	出願番号	が交付さ	n,
	PCT 国際出願	iとい	てに出	顔され,

### その発明は

### シリサイドの形成方法及び半導体装置の製造方法

という名称である。 そして、ここにその受領を認める対価で; 私/私達は、当該発明/出顧について、合衆国とその属領及び 全ての外国に於ける全面的かつ独占的な権利;合衆国とその属 領及び全ての外国に於いて発行される特許証に関わる全ての 権利、所有権、利益; 一部継続出願、継続出願、分割出願、 差替之出願、再発行出願、特許期間延長等、合衆国とその属領 及び全ての外国に於いて既に出願されたか若しくは今後出願 される特許に関わる全ての権利;そして、国際条約、同盟、契 約、法令、協定(将来制定されるものを含む)に基づく全ての 優先権を伴う一切の権利;を、日本国東京都新宿区西新宿2丁 目4番1号に住所を有するセイューエブソン株式会社、及び日 本国東京都千代田区丸の内2丁目4番1号に住所を有する株 式会社ルネサステクノロジ、その後継者、該受人及び法定代理 人に対して、売却、該族、移転するものとする。

さらに、私/私達は、セイコーエブソン株式会社及び株式会社 ルネサステクノロジ、(以下譲受人と言う)が単数ないしは複 数の当該発明(以下当該発明という)に関わる特許権を、自己 の名により、合衆国とその属領及び全ての外国に於いて出願 し、特許を受けること;またこの譲渡証の意図と目的を誠実に 実行することを求められた場合、下記に署名した私/私達が、 当該該受人、その後継者、その被譲渡者、及び法定代理人の費 用負担にて、一部継続出願、継続出顧、分割出願、差替え出願、 再発行出願、特許期間延長等を行い、合法的宣誓書、譲渡証、 委任状等の書類を作成し、あらゆる法的言たは難法的訴訟手統 に於いて証言を行うこと:当該発明とその経緯に関連して、下 記に署名した私/私達が知り得た全ての事実を、当該譲受人、 後継者、被譲渡者、及び法定代理人に連絡すること;そして当 該譲受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人が、当該発明の 特許権の適切な保護、維持、権利行使するために望ましいと考 慮すること、また、当該発明に関わる特許出願に際し、当該譲 受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人に対して法的権限を 付与することが望ましいと考慮することについて、可能な限り 行うことを承諾する。

# Assignment

For good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged. I/WE, the undersigned,

Yukimune WATANABE, Nobuyuki MISE, Shinji MIGITA

who have created a certain invention for which an application for United States Letters Patent

$\boxtimes$	executed by ME/US on even date herewith,	
	executed by ME/US on, (respectively).	
	filed on and assigned Serial No	
	filed as International Application No file	d o
	<del></del>	

and entitled:

METHOD FOR FORMING SILICIDE AND METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE

Do hereby sell, assign and transfer to Seiko Epson Corporation, a corporation of Japan, having a place of business at 4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, and Renesas Technology Corporation, having a place of business at 4-1, Marunouchi 2-chome. Chiyoda-ku, Tokyo, Japan their respective successors, assigns, and legal representatives, the full and exclusive right to said invention and said application and to any and all inventions described in said application for the United States, its territorial possessions and all foreign countries, and the entire right, title and interest in and to any and all Letters Patent which may be granted therefor in the United States, its territorial possessions and all foreign countries; and in and to any and all continuations-in-part, continuations, divisions, substitutes, reissues, extensions thereof, and all other applications for Letters Patent relating thereto which have been or shall be filed in the United States, its territorial possessions and/or any foreign countries, and all rights, together with all priority rights, under any of the international conventions, unions, agreements, acts, and treaties, including all future conventions, unions, agreements, acts, and treaties:

Agree that Seiko Epson Corporation and Renesas Technology Corporation hereinafter referred to as Assignees, may apply for and receive Letters Patent for said invention and said inventions, hereinafter referred to as said invention, in their own name, in the United States, its territorial possessions, and all foreign countries; and that, when requested to carry out in good faith the intent and purpose of this assignment, at the expense of said Assignees, their successors, assigns and legal representatives, the undersigned will execute all continuations in part, continuations, divisions, substitutes, reissues, extensions thereof, execute all rightful oaths. assignments, powers of attorney and other papers, testify in any legal or quasi legal proceedings; communicate to said Assignees. their successors, assigns or legal representatives all facts known to the undersigned relating to said invention and the history thereof, and generally do everything possible which said Assignees, their respective successors, assigns, or legal representatives shall consider desirable for aiding in securing, maintaining and enforcing proper patent protection for said invention and for vesting title to said invention and all applications for patents on said invention in said Assignees, their successors, assigns, or legal representatives;

Page 1 of 2

### Seiko Epson Ref. No.: J0125665US01

影響する、如何なる譲渡、授権、抵当権、ライセンス等その他 の協定も他の第三者との間で行っていないこと: 下記に署名 した私/私達によって、この書面に記載されている権利が所有 されていることを、当該競受人、後継者、被譲渡者、及び法定 代理人に対して誓約するものである。

表現によってのみ解釈されることに同意する。

上記を証明するため、私/私達は下記日付で署名する。

そして、私/私達は、この答面により譲渡された権利や財産に Covenant with said Assignees, their respective successors, assigns, or legal representatives that no assignment, grant, mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made to others by the undersigned, and that full right to convey the same as herein expressed is possessed by the undersigned.

さらに、下記に署名した私/私達はこの護族書は英語の部分の L/WE, the undersigned do further agree that this Assignment is to be construed solely according to the terms of the English language portions thereof.

> IN TESTIMONY WHEREOF I/WE have hereunto set MY/OUR signature seal on the date indicated below.

唯一または第一発明者名		Full name of sole or first inventor	
渡邉 幸宗		Yukimune WATANABE	
<b>発明者の署名</b>	日付	Inventor's signature	Date
第二共同発明者 (いる場合) 三瀬 信行		Full name of second joint inventor, if any Nobuyuki MISE	,
第二共同発明者の署名	日付	Second Inventor's signature	Date
第三共同発明者 (いる場合) 右田 真司		Full name of third joint inventor, if any Shinji MIGITA	,
第三共同発明者の著名	B付	Third Inventor's signature	Date
		右田真司	Feb 8, 2867
第四共同発明者(いる場合)		Full name of fourth joint inventor, if any	
第四共同発明者の署名	日付	Fourth Invantor's signature	Date
第五共同発明者(いる場合)		Full name of fifth joint inventor, if any	
第五共同党明督の著名	日付	Fifth Inventor's signature	Date
第六共同発明者(いる場合)		Full name of sixth joint inventor, if any	
第六共同発明者の署名	日付	Sixth Inventor's signature	Date
第七共同発明者(いる場合)		Full name of seventh joint inventor, if an	У
第七共同発明者の著名	呂付	Seventh Inventor's signature	Date
第八共同発明者 (いる場合)		Full name of eighth joint inventor, if any	
第八共同発明者の署名	日付	Eighth Inventor's signature	Date

Page 2 of 2

**PATENT** REEL: 018967 FRAME: 0293